

技術資料

EP-3000 絕緣接著劑

產品說明：

EP-3000 為單液型環氧樹脂絕緣接著劑，適用於一般小型半導體晶片，並可以自動機台黏著固定使用，對大多數材質皆有良好接著性。

產品特徵：

- 降低樹脂溢流及揮發的可能性。
- 中等黏度範圍可適用於沾膠或背膠之製程。

硬化前特性		測試條件	測試方法
比重	1.0~1.4 g/cc	比重計	FT-P001
外觀	白色		
黏度 @ 25°C	24000~28000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	1.0~1.4	Brookfield DV-III/CP-51 黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	FT-P008
細度	< 10 μ m	細度計	FT-P026
水含量	< 0.7 %	水份計	FT-P002
使用壽命 @ 25°C	24 hours	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P024
保存期限 @ -40°C	6 months		FT-P018
烘烤條件		測試條件	測試方法
標準烘烤條件		60 分鐘 @ 150°C (烘箱烘烤)	
物理及化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg)	127°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數	<Tg 49ppm/°C >Tg 190 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	>350 g/die	晶片尺寸 10mil × 10mil (銀支架)	FT-M012

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。